

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于合肥晶合集成电路股份有限公司

### 2023 年年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐人，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告，本持续督导期间为 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2023年度，保荐人督导晶合集成及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023年度持续督导期间内，经保荐人核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查工作要求，并确保了现场检查工作质量。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1.研发人员不足或流失风险

集成电路晶圆代工行业是典型的技术密集型行业，是一个涉及多学科跨领域的

综合性行业，高端、专业的人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础，研发团队对于公司保持竞争优势具有至关重要的作用。经过多年的发展和培养，公司已构建了一支成熟、创新能力强的核心研发团队，为公司新产品、新制程的研发和生产做出了突出贡献，但随着集成电路企业数量的不断增长，行业竞争持续加剧，企业之间人才的争夺也更加激烈。为保持人才队伍的稳定，公司高度重视人才队伍建设，并采取股权激励等多种措施吸引、留住优秀技术人员，但未来不排除因行业内竞争对手提供更优厚的待遇或其他因素导致公司关键技术人员流失且无法继续培养或招揽，对公司持续竞争力和未来发展造成不利影响。

## **2.研发进展不及预期风险**

公司所处的集成电路晶圆代工行业具有技术含量高、研发周期长、产品更新换代迅速、市场需求变化较快的特点。为适应行业发展及满足客户需求的变动，公司坚持技术创新的多元化路线，在新产品、新制程的研发上持续进行大量的资金及人员投入，迭代现有产品并推出新产品。但是如果公司在研发过程中的关键技术未能突破、相关性能指标未达预期、相应的特色工艺平台未能开发完成，或是相关产品推出市场后未获认可，均有可能导致市场开拓出现滞缓，对公司的持续盈利能力产生影响。

## **3.核心技术外泄或失密风险**

经过多年的技术创新和研发积累，公司储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产过程中的各个关键环节的数百项专利，同时，公司仍在持续进行多项针对主营业务的技术研发工作。公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了保密制度，与核心技术人员签署了保密协议，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出了严格规定，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。但是由于技术秘密保护措施的限制及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。未来，公司若在经营过程中因内部管理不善、工作疏忽、外部窃取等原因导致核心技术泄密或被盗用，可能削弱公司的核心竞争力，影响公司的市场竞争优势，对公司业务增长造成不利影响。

## **(二) 经营风险**

## **1.业绩大幅下滑或亏损的风险**

2023 年度（以下简称“报告期”或“本期”），公司实现营业收入 724,354.14 万元，较上年同期下降 27.93%；实现净利润 11,916.48 万元，较上年同期下降 96.22%，主要系 2023 年半导体行业景气度下滑、市场复苏缓慢、市场竞争加剧及持续性研发投入所致。若公司未来研发项目进展或研发成果产业化不及预期，或不能有效应对市场景气度无法回升、终端市场消费需求不足、市场库存消化较慢等多重环境变化，业绩有继续下滑的风险。

## **2.客户集中度较高的风险**

报告期内，公司前五大客户的销售收入合计 461,827.05 万元，占营业收入的比例为 63.76%，客户集中度较高。公司目前与主要客户保持了良好的合作关系并与部分客户签署了长期框架协议，未来如果公司的主要客户因市场竞争加剧、宏观经济波动等原因生产经营出现问题或采购战略发生较大变化，导致其向公司下达的订单数量大幅下降，且公司未能及时拓展新的客户源，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

## **3.新产品需求不及预期风险**

公司一直重视新产品和新制程的研发工作，目前 40nm 高压 OLED 驱动芯片已经开发成功并正式流片，28nm 的产品开发正在稳步推进中，若新产品陆续研发落地、通过认证及量产，将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新产品能否研发落地、通过认证及量产取决公司自身研发实力、市场拓展能力、客户需求变化等多种因素影响，公司存在新产品需求不及预期的风险。

## **4.公司产品结构相对单一的风险**

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务。目前公司产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域，未来如果面板显示驱动芯片市场需求发生较大波动，公司在该领域的生产或销售出现不利变化，且未能及时完成 CIS、PMIC、MCU 等其他技术平台的研发及扩产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或 40nm 和 28nm 新制程、新产品的研发或需求不及预期，则可能对公司的现金流、盈利能力产生不利影响。

### **(三) 财务风险**

#### **1. 外汇汇率波动风险**

报告期内，公司存在境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。虽然公司在业务开展时已考虑了订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但难以预测境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素可能对人民币与美元或日元汇率产生的影响，若未来美元或日元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来经营业绩的稳定造成不利影响。

#### **2. 毛利率波动的风险**

报告期内，公司主营业务毛利率为 21.46%，较上年同期下降 24.65 个百分点。公司综合毛利率受产品结构、市场供求关系、公司议价能力、技术先进性、市场销售策略等因素的影响。此外，公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含厂房、设备折旧等，价格、稼动率对毛利率影响较大。未来，如果宏观经济形势发生变化，行业复苏不及预期，市场需求不足，将影响产品销量及价格，或公司加速产能扩充使得一定时期内折旧费用大幅增加，将可能导致公司毛利率水平出现波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **3. 固定资产投资风险**

集成电路晶圆代工行业是典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高。公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。虽然公司统筹制定了固定资产投资规划与资金筹措安排，但在实际建设过程中，受宏观经济形势、融资市场环境变化等不可控因素影响，公司可能面临一定的资金压力；另随着大额固定资产的增加，折旧费用也相应增加，若公司未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临盈利能力下降的风险。

#### **4. 存货跌价准备风险**

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。报告期末，公司存货的账面价值为 149,268.54 万元，计提的存货跌价准备余额为 10,172.91 万元。公司结合自

身对市场的判断和客户的订单需求拟定采购计划，若未来市场环境发生变化、竞争加剧、产品技术迭代更新，公司对市场需求的预测出现偏差，或者客户的订单未来无法执行，使得库存产品滞销、存货积压，可能导致存货库龄变长、可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

#### **（四）行业风险**

##### **1.产业政策变化风险**

公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国家陆续出台了包括《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，为国内集成电路行业的发展带来了良好的发展机遇，集成电路行业整体的设计能力、生产工艺水平、自主创新能力有了较大的提升。如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司的业务发展、人才引进、生产经营产生一定不利影响。

##### **2.市场竞争加剧风险**

近年来，在产业政策和地方政府的推动下，集成电路晶圆代工行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加，竞争日趋激烈。公司经过多年的发展与积累，通过自研工艺的迭代与大量产品的设计、生产实践，已积累了丰富的产品开发和生产经验，但相对行业龙头晶圆代工厂商，公司在技术先进性、市场竞争力上还存在一定差距。未来，如果公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，将削弱公司的竞争优势。

##### **3.供应链风险**

集成电路晶圆代工行业对原材料、零备件、软件和设备等的质量和技术性要求较高，部分重要原材料、零备件、软件、核心设备等在全球范围内的合格供应商数量较少，且大多来自中国境外。未来，如果因为地缘政治等因素，公司重要原材料、

零备件、软件、设备等的出口许可、供应、物流受到限制或价格上涨，将可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

## （五）宏观环境风险

### 1.国际贸易摩擦风险

近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护、技术限制的手段，对我国相关产业的发展造成了一定程度的负面影响。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因贸易政策、关税、出口限制或其他贸易壁垒进一步恶化导致公司业务受限、公司采购范围受限、供应商供货或者终端客户采购受到约束，将会对公司的正常生产经营产生不利影响。

### 2.宏观经济波动和行业周期性风险

公司是集成电路晶圆代工企业，主要从事集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售，属于集成电路行业的中游环节。由于集成电路行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电子领域市场规模将受到较强的冲击，终端销量的下滑也将让下游客户在备货策略上更为保守，导致需求下降，包括公司在内的集成电路企业将面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

## 四、重大违规事项

2023 年度持续督导期间内，晶合集成不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年，晶合集成主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

项目	2023年度/2023年末	2022年度/2022年末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	724,354.14	1,005,094.86	-27.93
归属于上市公司股东的净利润	21,162.91	304,543.08	-93.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,712.95	287,834.64	-98.36



项目	2023年度/2023年末	2022年度/2022年末	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,103.60	628,003.34	-102.56
归属于上市公司股东的净资产	2,140,980.47	1,312,415.66	63.13
总资产	4,815,627.96	3,876,457.45	24.23

2023年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.12	2.02	-94.06
稀释每股收益（元/股）	0.12	2.02	-94.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	1.91	-98.43
加权平均净资产收益率（%）	1.09	26.91	减少25.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.24	25.44	减少25.20个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.60	8.53	增加6.07个百分点

2023年度，晶合集成上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

营业收入较上年同期减少 280,740.72 万元，同比下降 27.93%，主要系报告期内半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 283,380.17 万元，同比下降 93.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 283,121.69 万元，同比下降 98.36%，主要系报告期内：1.因公司营业收入同比下降，且固定成本较高，导致产品毛利水平同比下降；2.公司持续增加研发投入，研发费用较上年同期增长 23.39%；3.财务费用受汇率波动影响较上年同期增长 122.99%。

归属于上市公司股东的净资产较上年年末增加 828,564.81 万元，同比增长 63.13%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金，股本和资本公积相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 644,106.94 万元，同比下降 102.56%，主要系报告期内受市场景气度影响，营业收入降低，销售商品、提供劳务

收到的现金减少以及前期收取的产能保证金到期返还所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

公司已建立了完善、成熟的研发机制，囊括市场调研、可行性评估、技术研发、流片验证等核心环节，在敏锐洞悉市场需求的同时，提高研发效率、控制研发成本，实现了高效可靠的研发与商业应用。公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，拥有在行业内多年的技术研发经验。

公司持续进行研发团队的建设与研发能力的提升。报告期内，研发投入105,751.18万元，占营业收入的比例为14.60%。截至2023年末，公司拥有4,594名员工，其中研发技术人员1,660名，占员工总数比例为36.13%。

### （二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

公司不断致力于丰富自身产品结构及强化自身技术能力。报告期内，公司已实现DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic等平台各品类产品量产，平台及产品结构日益丰富，产品应用涵盖消费电子、智能手机、智能家电、安防、工控、车用电子等诸多领域，可为客户提供丰富的产品解决方案。公司产品工艺制程已覆盖150nm至55nm，同时40nm、28nm正在进行开发，技术能力稳步增强。

### （三）位居合肥战略核心，服务广阔产业市场

合肥市作为国家级科技创新型试点城市，制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏汽合”的产业发展战略，已形成新型显示器件、集成电路、新能源汽车和人工智能等新兴产业，终端芯片需求旺盛。公司所处的半导体代工环节，为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟的制程制造经验，配套服务于合肥产业链规划，提供关键芯片，促进产业链联动发展，是合肥市产业发展规划的重要组成部分。

### （四）客户关系紧密持久，推动国产供应替代

公司客户群已覆盖国际一线客户，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，与越来越多的企业建立了长期合作关系。

公司在业界具有良好的口碑及供应商基础，最大程度地采用国产化设备与材料，推动中国大陆供应链国产替代。设备方面已成功导入如北京北方华创微电子装备有限公司、中微半导体设备（上海）股份有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公司、北京屹唐半导体科技股份有限公司、拓荆科技股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司等国产设备领先厂商，材料方面也已完成如广东华特气体股份有限公司、广州广钢气体能源股份有限公司、上海超硅半导体股份有限公司、中环领先半导体科技股份有限公司、西安奕斯伟硅片技术有限公司等国产材料供应。

#### （五）体系认证齐全，质量稳定可靠

公司始终重视质量管理体系建设，截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、有害物质过程管理体系 QC080000、温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证，并通过多个工艺平台的车规验证。

#### （六）智能制造，高效稳定，成本具有竞争力

2020 年公司智能生产线获得安徽省智能工厂认证，其高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的品质。

此外，公司持续深耕本地产业链配套，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，使自身产品成本更具竞争力。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	105,751.18	85,707.00	23.39
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	105,751.18	85,707.00	23.39

项目	本年度	上年度	变化幅度(%)
研发投入总额占营业收入比例(%)	14.60	8.53	增加 6.07 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

## (二) 研发进展

1、55nm 铜制程平台及 145nm 低功耗高速显示驱动平台开发完成；

2、自主研发的 55nm 触控与显示整合驱动芯片产品已实现大规模量产；

3、40nm 高压 OLED 平台产品客户试产中；

4、车用 110nm 显示驱动芯片在车规 CP 测试良率已达到良好标准，并于 2023 年 3 月完成 AEC-Q100 车规级认证，于 2023 年 5 月通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。

报告期内，公司新增发明专利共 231 项，实用新型专利 44 项，软件著作权 3 项。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### (一) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，晶合集成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91

项目	金额
加：尚未支付的发行费用	2,981,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	49,959,764.91
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	5,809,709,374.31
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	3,629,676,937.34
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	104,807,882.56
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	2,100,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户应有余额(d)	1,806,748,337.50
截至2023年12月31日募集资金专户实际余额(e)	1,806,748,337.50
差异(d-e)	0.00

公司于2023年6月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,075,224,554.41元及已支付的发行费用的自筹资金人民币16,782,836.60元，金额共计人民币2,092,007,391.01元。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2088号）。截至2023年12月31日，上述置换事项已完成。

公司于2023年6月21日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币亿元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	是否赎回
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制418期固定收益凭证	保本固定收益	0.50	2023/7/13	2024/4/15	否
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制417期固定收益凭证	保本固定收益	2.00	2023/7/13	2024/5/13	否
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列121期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	10.00	2023/7/14	2023/10/13	是
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列122期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	10.00	2023/7/14	2023/10/13	是
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享755号收益凭证	保本固定收益	3.00	2023/7/17	2024/5/7	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍78号浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/4/17	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈92期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/7/18	2024/2/19	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利40期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/1/16	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利42期浮动收益凭证	保本浮动收益	0.50	2023/7/18	2024/1/16	否
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利41期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/7/18	2024/5/20	否
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利20期浮动收益凭证	保本浮动收益	1.00	2023/9/1	2024/3/4	否
国元证券股份有限公司	国元证券元聚利21期浮动收益凭证	保本浮动收益	2.00	2023/9/1	2024/3/4	否
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制447期固定收益凭证	保本固定收益	1.00	2023/9/1	2023/11/30	是
中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动65号收益凭证	保本浮动收益	2.00	2023/9/4	2024/3/4	否
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列136期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	2.00	2023/10/13	2024/1/11	否
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列135期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本固定收益	4.00	2023/10/13	2024/1/11	否
国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制500期固定收益凭证	保本固定收益	1.00	2023/12/1	2024/3/4	否

2023年6月21日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）、《晶合集成2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。截至2023年12月31日，上述超募资金人民币6,000万元已从募集资金存放专项账户转出至公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。

公司于2023年12月22日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”予以结项，并将节余募集资金人民币34,214.87万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，中金公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）、《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。截至2023年12月31日，公司尚未将节余募集资金从募集资金存放专项账户转出。

2023年6月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公

告》（公告编号：2023-006）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付了募投项目所需资金共计人民币 287,941,603.52 元，以募集资金人民币 104,807,882.56 元进行了等额置换，剩余人民币 183,133,720.96 元待置换。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份的资金来源为公司超募资金、自有及自筹资金，截至本报告出具日该方案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公告编号：2023-042）、《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见》、《晶合集成 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	622,837,433.71
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	221,885,630.67
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	603,255,193.98
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	10,177,467.51
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	239,271,590.62
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	2,570,856.05
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	106,750,164.96
合计		<b>1,806,748,337.50</b>

注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 2,100,000,000.00 元。

## （二）募集资金合规情况

公司曾误使用 144,339.62 元募集资金支付发行费用（审计费）对应的增值税，所涉募集资金金额较小，未对募集资金投资项目进程产生不利影响，且公司现已从自有资金账户中将前述 144,339.62 元归还至原募集资金存放专项账户。



除前述情况外，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，晶合集成董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱显寰	资深副总经理	聘任	公司经营管理需要
郑志成	资深副总经理	聘任	公司经营管理需要
吴志楠	助理	聘任	公司经营管理需要
黎翠綾	助理	聘任	公司经营管理需要
张伟瑾	助理	聘任	公司经营管理需要
方华	助理	聘任	公司经营管理需要
郭圣忠	助理	聘任	公司经营管理需要

截至 2023 年 12 月 31 日，晶合集成现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份变动的情况如下：

姓名	职务	年初持股数	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量（股）	增减变动原因
蔡国智	董事长	0	73,543	73,543	二级市场买卖
朱才伟	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理	0	260,931	260,931	二级市场买卖
蔡辉嘉	总经理、核心技术人员	0	60,000	60,000	二级市场买卖
周义亮	副总经理	0	142,372	142,372	二级市场买卖
郑志成	资深副总经理	0	10,000	10,000	二级市场买卖
方华	助理	0	81,822	81,822	二级市场买卖
合计	/	0	628,668	628,668	/

注：以上持股均为直接持股，不含间接持股。

截至 2023 年 12 月 31 日，晶合集成的控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

2023 年度，公司营业收入合计 724,354.14 万元，较上年同期下降 27.93%；归属于母公司所有者的净利润 21,162.91 万元，较上年同期下降 93.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,712.95 万元，较上年同期下降 98.36%。

报告期内公司营业收入下降主要系半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓所致。因公司营业收入同比下降，固定成本较高，导致产品毛利水平同比下降，且公司持续增加研发投入，加之财务费用受汇率波动影响较上年同期增长，导致公司利润水平较上年同期高景气度环境存在大幅降低。保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（二）经营风险”之“1.业绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。

未来，保荐人将督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 周玉  
周玉

李义刚  
李义刚

